

信頼性試験結果 Reliability Test

XCL209 シリーズ

XCL209 Series

 パッケージ : USP-10B03

 RoHS対応品 / RoHS Compliance
 ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	85°C VIN=6.3V VOUT=1.08V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	125°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=6.3V VOUT=1.08V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-55°C~125°C 各30分 30min each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカー UHAST	125°C85%RH 2×10 ⁵ Pa	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	30°C60%RH192h→reflow (150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec) 3times Moisture Sensitivity Level 3 Based on IPC/JEDEC J-STD-020	-	0/22
7	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM R=0Ω C=200pF ±200V以上 R=0Ω C=200pF ±200V over	3回 3 times	0/5
		HBM R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 R=1500Ω C=100pF ±1kV over	3回 3 times	0/5
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 R=0Ω C=200pF ±100V over	3回 3 times	0/5
		50mA以上 50mA over	3回 3 times	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	接合強度試験 Adhesive Strength Test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回 (EIAJ ED4702) Strain 5mm 5±1s 1time (EIAJ ED4702)	0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒 (プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)	0/11